

2-1-2-7 鉄基板 SR 付着物剥がれ／鉄基板附着 SR 并剥落／ Peeled off solder resist on iron-base printed board

【特徴】鉄基板の表面に異物形状の S R 未着部が残されている欠陥、剥がれ部の鉄板が腐食している（錆びている）場合もある。

【特征】在铁基板表面留下杂物形状的 S R 剥落的缺陷，剥落部位往往被腐蚀（氧化）。

【Characteristics】 Solder resist is missing on an iron-base board in the shape of some foreign object. Sometimes the exposed area of the iron board is corroded (rusted).

【原因・判断ポイント・発生工程】 S R 塗布前に鉄板面に付着した異物が、 S R 塗布後に剥がれたために出来たもの（ S R 塗布前工程～ S R 塗布後工程）

【原因、判断要点、发生工序】在 SR 涂布前，铁基板表面附着的杂物在 SR 涂布后剥落所引起的（ SR 涂布前工序～ S R 涂布后工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
A foreign object adhered to the surface of an iron-base board before solder resist coating is peeled off after coating to cause the defect. (Before solder resist coating - after solder resist coating)



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

2-1-2-8 SR 衝突剥がれ／ SR 碰撞的剥落／ Peeled off solder resist by impact

【特徴】 S R 表面に何かが衝突した状態の S R 剥がれ

【特征】 SR 表面受到某种碰撞而剥落。

【Characteristics】 Something hits the solder resist surface and peels off the resist.

【原因・判断ポイント・発生工程】 S R 塗布乾燥後のハンドリング作業時に、不注意に何かにぶつけ、 S R が剥がれたもの（ S R 塗布乾燥後工程）

【原因、判断要点、发生工序】涂布 SR 后的搬运作业时，不小心碰撞某种物体而引起 SR 剥落（ SR 烘干后工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
Something hits the solder resist surface by careless handling and peels off the resist after solder resist application. (After solder resist coating and curing process)



【コメント】
顕微鏡倍率× 80

【注釋】
显微镜倍率 × 80

【Comments】
Magnification: ×80



【コメント】
顕微鏡倍率× 70

【注釋】
显微镜倍率 × 70

【Comments】
Magnification: ×70